

行业及产业

电子

强于大市

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势:



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

相关研究

- 《电子行业周报: 长鑫科技启动科创板 IPO, 加码 DRAM 国产替代》2026-07-13
- 《电子行业周报: 华为发布稻定律 V2, 先进封装、硅光、AI 算力迎来发展新机遇》2026-07-06
- 《电子行业周报: HBM 需求旺盛推动 Micron 业绩大幅增长》2026-06-29
- 《电子行业周报: SK Hynix 送样 12 层 HBM4E, AI 高端存储迭代提速》2026-06-22
- 《电子行业周报: NVIDIA 携手 SK Hynix 共建 AI 内存与半导体智造新生态》2026-06-15

证券分析师

许亮
S0820525010002
0755-83562506
xuliang@ajzq.com

联系人

朱俊宇
S0820125040021
021-32229888-25520
zhujunyu@ajzq.com

HPC 成增长核心引擎, 台积电上调资本开支拓宽长期成长空间

——电子行业周报 (20260713-20260719)

投资要点:

- **电子板块行情复盘:** 本周 SW 电子指数下跌 18.84%, 跑输沪深 300 指数 (-5.26%), 在 31 个 SW 一级行业指数中位列第 31 名。板块整体持续回调, 各细分同步走弱, 半导体材料、其他电子Ⅲ、数字芯片设计跌幅居前, 分别下跌 28.26%、25.31%、22.34%。
- **个股方面:** 本周 SW 电子板块个股涨跌分化明显, 格林精密 (+26.24%)、漫步者 (+9.28%)、福蓉科技 (+7.32%)、国光电器 (+5.74%)、安克创新 (+4.42%) 为本周板块涨幅居前的; 板块回调幅度显著, 跌幅前五标的分别为利扬芯片 (-39.62%)、菲沃泰 (-39.31%)、普冉股份 (-39.12%)、实益达 (-38.94%)、恒烁股份 (-38.77%)。
- **2026 年 7 月 16 日, 台积电在法说会上公布了 2026Q2 财报。**财报数据显示, 台积电 2026Q2 营收达到 402 亿美元 (环比+12.0%, 同比+33.7%), 公司净利润约为 7065.6 亿新台币, 每股盈余为 27.3 元新台币。**1) 先进制程层面,** 2026Q2 公司各类芯片营收占比排名前五的工艺节点依次为, 5nm (33%)、3nm (30%)、7nm (11%)、16/20nm (6%)、28nm (6%)。本季度 2nm 先进制程实现首次规模化出货, 贡献晶圆营收比重 3%, 这意味着公司最前沿工艺正式实现商业化落地, 7nm 及以下先进制程合计贡献晶圆总收入 77%, AI 算力需求持续拉动高端工艺放量。**2) 应用平台结构上,** 高性能运算 (HPC) 和智能手机 (Smartphone) 分别占营业收入的 66%和 22%, 是台积电两大核心收入来源。其中 HPC 占比较 2026Q1 的 61%提升了 5pct, 主要受益于全球 AI 服务器、GPU、TPU 等算力芯片订单持续放量, 3nm 先进制程产能集中供给 AI, 叠加 CoWoS 先进封装配套需求爆发。物联网 (IoT)、汽车电子 (Automotive)、数字消费电子 (DCE) 及其他业务占比分别为 5%、4%、1%和 2%, 与 2026Q1 保持一致。**3) 资本开支端,** 2026Q2 单季台积电资本开支 157 亿美元, 上半年累计达 268 亿美元。同时公司将 2026 全年资本开支指引由此前 520-560 亿美元上调至 600-640 亿美元。**4) 未来展望,** 公司预计 2026Q3 营收 446-458 亿美元, 毛利率、营业利润率分别指引 65%-67%、56%-58%。我们认为, 台积电大幅上调资本开支并加码先进封装配套投入, 叠加 AI 算力芯片持续推高 CoWoS 产能需求, 全球高端 2.5D 先进封装供给紧张的格局或将长期延续。
- **投资建议: 建议关注高性能计算及先进封装产业链投资机会。**当前高性能计算芯片已成为台积电先进制程与先进封装需求的核心驱动力, HPC 营收占比达 66%, 显著高于智能手机等传统业务, 增长确定性与景气稳健性突出。台积电上调 2026 年资本开支指引至 600-640 亿美元, 进一步验证 AI 算力、高端封装赛道长期高景气。
- **风险提示: 1) 2nm 先进制程工艺进展不及预期:** 台积电 2nm 工艺当前尚处于规模化量产爬坡初期, 全新 GAA 纳米片架构工艺复杂、良率提升难度较高, 叠加高 NA EUV 设备供给受限, 需依靠多重曝光方案生产, 晶圆产出效率偏低、单片制造成本显著抬升。若 2nm 良率爬坡节奏、产能释放进度慢于内部规划, 新工艺高成本状态将长期延续, 持续稀释公司整体毛利率。**2) AI 算力需求不及预期的风险:** 公司当前营收高度依赖高性能运算业务, HPC 板块占整体净营收比重达 66%, 业绩增长与全球 AI 服务器、GPU、TPU 芯片资本开支高度绑定。若海外云厂商大模型研发迭代放缓、下游 AI 落地应用需求疲软, 客户将下调先进制程投片与 CoWoS 先进封装订单规模, 叠加当前行业头部代工同步大规模扩产高端晶圆与封装产能, 供需格局或逐步转弱, 代工报价存在下行压力, 公司营收增速、盈利水平均存在回落风险。

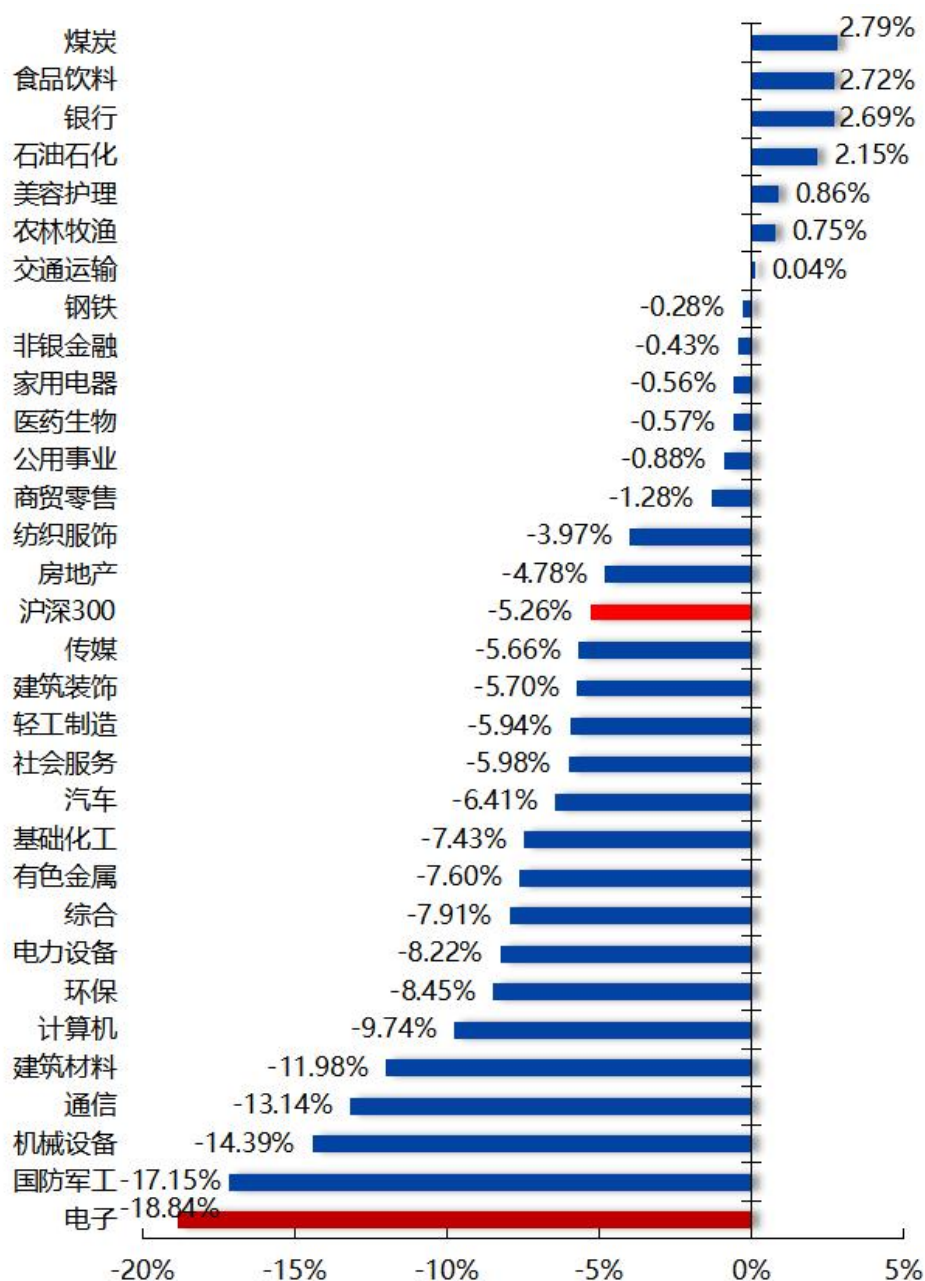
1. 本周市场回顾

1.1 SW 一级行业涨跌幅一览

本周 SW 电子指数下跌 18.84%，大幅跑输沪深 300 指数（-5.26%），在全部 31 个 SW 一级行业中排名 31 位，板块整体持续回调。

SW 一级行业涨跌幅排名前五的板块分别为：煤炭（+2.79%）、食品饮料（+2.72%）、银行（+2.69%）、石油石化（+2.15%）、美容护理（+0.86%）。排名后五的板块分别为：电子（-18.84%）、国防军工（-17.15%）、机械设备（-14.39%）、通信（-13.14%）、建筑材料（-11.98%）。

图表 1：本周 SW 一级行业涨跌幅一览



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.2 SW 电子三级行业市场表现

本周 SW 电子三级行业分化显著，涨跌幅排名前三的细分赛道分别为品牌消费电子（-3.91%）、印制电路板（-9.38%）、分立器件（-15.07%）；涨跌幅排名后三的细分赛道分别为半导体材料（-28.26%）、其他电子Ⅲ（-25.31%）、数字芯片设计（-22.34%）。

图表 2：本周 SW 电子三级行业涨跌幅一览

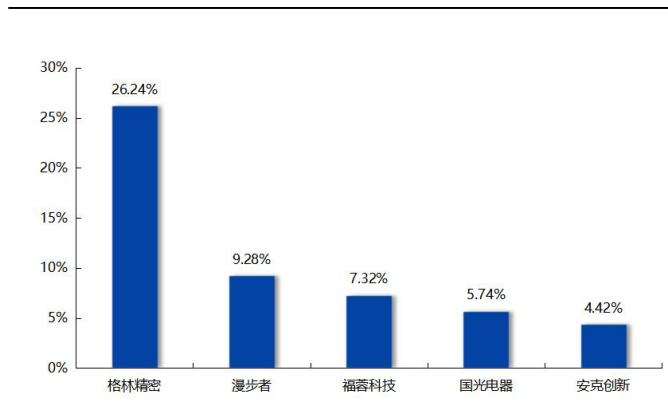


资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.3 SW 电子行业个股情况

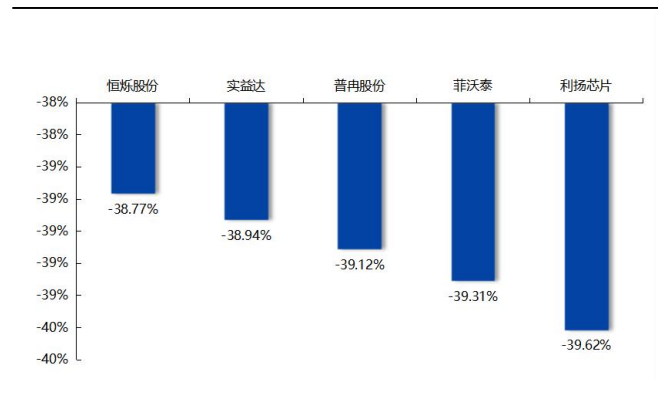
本周 SW 电子板块个股涨跌分化明显，格林精密（+26.24%）、漫步者（+9.28%）、福蓉科技（+7.32%）、国光电器（+5.74%）、安克创新（+4.42%）为本周板块涨幅居前标的；板块回调幅度显著，跌幅前五标的分别为利扬芯片（-39.62%）、菲沃泰（-39.31%）、普冉股份（-39.12%）、实益达（-38.94%）、恒烁股份（-38.77%）。

图表 3：SW 电子个股本周涨跌幅前五



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

图表 4：SW 电子个股本周涨跌幅后五

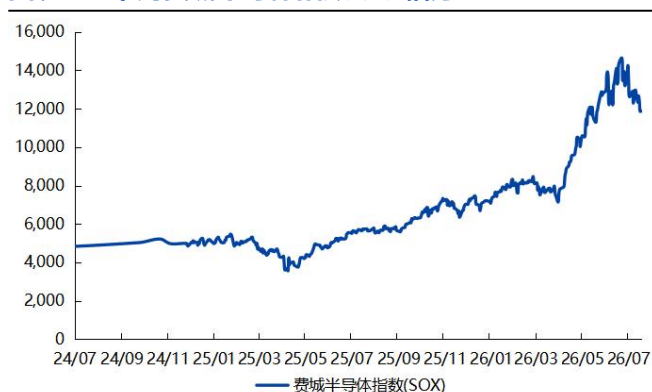


资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.4 SW 科技行业其他市场表现

费城半导体指数 (SOX) 本周涨跌幅为-9.97%，恒生科技指数本周涨跌幅为-2.09%。

图表 5：本周费城半导体指数涨跌幅为-9.97%



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

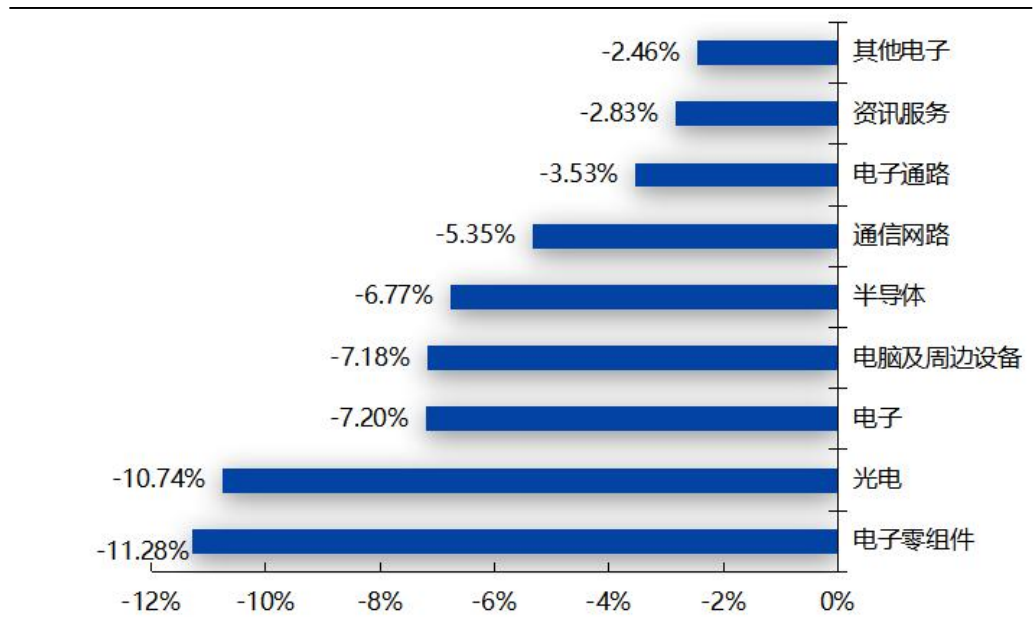
图表 6：本周恒生科技指数涨跌幅为-2.09%



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

中国台湾电子指数各细分板块本周涨跌幅分别为：其他电子 (-2.46%)、资讯服务 (-2.83%)、电子通路 (-3.53%)、通信网路 (-5.35%)、半导体 (-6.77%)、电脑及周边设备 (-7.18%)、电子 (-7.20%)、光电 (-10.74%)、电子零组件 (-11.28%)。

图表 7：中国台湾电子指数本周涨跌幅一览



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

2. 全球产业动态

2.1 台积电召开 2026Q2 法说会

新闻：2026 年 7 月 16 日，台积电召开 2026Q2 法说会。作为全球晶圆代工龙头，公司在本次会议中详细披露当期经营业绩，并阐述中长期发展战略。

营业收入：台积电 2026Q2 营收达到 402 亿美元（环比+12.0%；同比+33.7%），位于公司 390-402 亿美元的指引上限；同时，公司净利润约为 7065.6 亿新台币（环比+23.4%；同比+77.4%），每股盈余为 27.3 元新台币（环比+23.4%；同比+77.4%）。2026Q2 台积电毛利率为 67.7%，净利率为 55.6%。

1) 按先进制程工艺节点划分，2026Q2 各类芯片营收占比排名前五的工艺节点依次为：5nm (33%)、3nm (30%)、7nm (11%)、16/20nm (6%)、28nm (6%)。本季度 2nm 先进制程实现首次规模化出货，贡献晶圆营收比重 3%，标志公司最前沿工艺正式进入商业化收获期；7nm 及以下先进制程合计贡献晶圆总收入 77%，AI 算力需求持续拉动高端工艺放量。

2) 按应用平台划分营收结构，高性能运算（HPC）和智能手机（Smartphone）分别占营业收入的 66%和 22%，是台积电两大核心收入来源。其中 HPC 占比较 2026Q1 的 61%提升 5pct，主要受益于全球 AI 服务器、GPU、TPU 等算力芯片订单持续放量，3nm 先进制程产能集中供给 AI，叠加 CoWoS 先进封装配套需求爆发；同时智能手机业务阶段性走弱，进一步抬升 HPC 在整体营收中的权重。物联网（IoT）、汽车电子（Automotive）、数字消费电子（DCE）及其他业务占比分别为 5%、4%、1%和 2%，与 2026Q1 保持一致。

资本开支：台积电将 2026 全年资本开支指引由此前 520-560 亿美元上调至 600-640 亿美元。资金分配结构清晰：约 70%-80%投向先进制程，10%用于特色工艺，剩余

10%–20%分配至先进封装、芯片测试、光罩制造等配套环节。公司 2026Q2 资本支出达 157 亿美元，环比提升 41.4%；上半年累计资本开支 268 亿美元。

未来展望：对于 2026Q3 经营表现，台积电给出营收指引区间 446–458 亿美元，取区间中值测算，单季度营收环比增长约 12%；毛利率预期 65%–67%，营业利润率预期 56%–58%。公司管理层提及，2nm 工艺尚处于量产爬坡初期，相关成本投入或将对三季度毛利率形成阶段性压制，但 AI 加速器、高端先进逻辑芯片及数据中心算力芯片的旺盛需求，仍将持续支撑公司营收保持上行态势。

爱建观点：建议高性能计算及先进封测产业链投资机会。当前高性能计算芯片已成为台积电先进制程与先进封装需求的核心驱动力，HPC 营收占比达 66%，显著高于智能手机等传统业务，增长确定性与景气稳健性突出。台积电上调 2026 年资本开支指引至 600–640 亿美元，进一步验证 AI 算力、高端封装赛道长期高景气。

2.2 ASML 发布 2026Q2 财报

新闻：2026 年 7 月 15 日，ASML 发布 2026Q2 财报。受益于人工智能（AI）相关设备投资的持续强劲需求，ASML 2026Q2 实现营收 93.26 亿欧元，同比增加 21%；净利润为 29.18 亿欧元，同比增长约 27%；公司毛利率达 54%。

公司光刻系统净销售额 66 亿欧元，其中 EUV 设备收入过半；设备维保、软件升级等配套业务创收 27.62 亿欧元。

AI 基建扩张拉动先进逻辑芯片、HBM 与存储芯片需求，各大芯片厂商加速扩产，加大先进光刻机采购量，存量设备运维升级需求同步走高。

受益于强劲客户需求，ASML 上调全年业绩预期，2026 年净销售额目标调整至 430–450 亿欧元；全年毛利率预期上调至 54%–56%。公司预测 2026Q3 净销售额 110–120 亿欧元，毛利率 55%–57%，同时计划扩充 EUV、DUV 光刻机产能，承接客户未来数年扩产订单。

爱建观点：全球 AI 算力资本开支持续加码，先进光刻设备需求刚性不减，EUV 设备出货维持高增，存量设备服务持续兑现稳定现金流，公司全年业绩或将持续上扬。

2.3 月之暗面正式推出 Kimi K3

新闻：2026 年 7 月 17 日，月之暗面正式推出 Kimi K3 模型。该模型参数规模达 2.8 万亿，同时也是全球首个开源的 3 万亿级别大模型。Kimi K3 依托 KDA 混合线性注意力机制与注意力残差技术搭建，原生支持视觉理解，同时具备百万级 Token 超长上下文窗口；模型进一步优化 MoE 稀疏架构，结合 Stable LatentMoE 框架，可在 896 个专家中高效激活 16 个专家单元。

计费方面，Kimi K3 采用输入、输出 Token 分开计价的模式，计费单位为每百万 Token，

其中输入 Token 分缓存命中 2 元、未缓存 20 元，同时输出 Token 统一按照 100 元/百万 Token 计费。

爱建观点：Kimi K3 凭借超大参数量、百万级长上下文与原生多模态能力，叠加优化后的稀疏 MoE 架构，大幅提升开源大模型性能上限；分层输入定价模式降低高频复用场景使用成本，商业化落地优势突出。

2.4 摩尔线程发布 2026H1 业绩预告

新闻：2026 年 7 月 17 日，摩尔线程发布 2026H1 业绩预告。业绩预告数据显示：公司预计 2026H1 营收 16.50-17.50 亿元，同比增加 135.12%-149.37%。

公司业绩高增主要受益于 AI 产业快速发展，国内国产 GPU 市场需求持续旺盛。

研发层面，公司持续加大投入、迭代 GPU 芯片架构，完善云、边、端全场景产品布局；旗下旗舰训推一体全功能 GPU 智算卡 MTT5000 已实现规模量产，综合性能位居行业领先梯队。依托 MTT5000，摩尔线程持续落地交付大规模智算集群，该集群可承载万亿参数大模型训练，整体算力效率对标海外同代先进产品。

爱建观点：AI 算力需求持续爆发叠加国产替代红利释放，公司核心 GPU 产品实现量产交付，智算集群商业化顺利落地，驱动公司营收高增。

3. 风险提示

1) 2nm 先进制程工艺进展不及预期：台积电 2nm 工艺当前尚处于规模化量产爬坡初期，全新 GAA 纳米片架构工艺复杂、良率提升难度较高，叠加高 NA EUV 设备供给受限，需依靠多重曝光方案生产，晶圆产出效率偏低、单片制造成本显著抬升。若 2nm 良率爬坡节奏、产能释放进度慢于内部规划，新工艺高成本状态将长期延续，持续稀释公司整体毛利率。

2) AI 算力需求不及预期的风险：公司当前营收高度依赖高性能运算业务，HPC 板块占整体净营收比重达 66%，业绩增长与全球 AI 服务器、GPU、TPU 芯片资本开支高度绑定。若海外云厂商大模型研发迭代放缓、下游 AI 落地应用需求疲软，客户将下调先进制程投片与 CoWoS 先进封装订单规模，叠加当前行业头部代工厂同步大规模扩产高端晶圆与封装产能，供需格局或逐步转弱，代工报价存在下行压力，公司营收增速、盈利水平均存在回落风险。

爱建证券有限责任公司

上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号

电话: 021-32229888

传真: 021-68728700

服务热线: 956021

邮政编码: 200124

邮箱: ajzq@ajzq.com

网址: <http://www.ajzq.com>

评级说明

投资建议的评级标准

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场：沪深 300 指数（000300.SH）；新三板市场：三板成指（899001.CSI）（针对协议转让标的）或三板做市指数（899002.CSI）（针对做市转让标的）；北交所市场：北证 50 指数（899050.BJ）；香港市场：恒生指数（HIS.HI）；美国市场：标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）。

股票评级

买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5% ~ 15% 之间
持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5% ~ 5% 之间
卖出	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%

行业评级

强于大市	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
弱于大市	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告采用信息和数据来自公开、合规渠道，所表述的观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的独立看法。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法可能存在局限性，请谨慎参考。

法律主体声明

本报告由爱建证券有限责任公司（以下统称为“爱建证券”）证券研究所制作，爱建证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管。

本报告是机密的，仅供我们的签约客户使用，爱建证券不因收件人收到本报告而视其为爱建证券的签约客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但爱建证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供签约客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，爱建证券及其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测后续可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，爱建证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

版权声明

本报告版权归爱建证券所有，未经爱建证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。版权所有，违者必究。